



# 第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

**演讲题目:** 用于 AI 应用的 3D 先进封装

**演讲人:**王愉博 研发中心副总裁 矽品

## 演讲摘要:

生成式 AI 和大型语言模型 (LLM) 的激增对计算能力、内存带宽和容量提出了前所未有的要求,推动了 AI 和高性能计算 (HPC) 应用的封装创新。本演讲深入探讨了小芯片技术在晶圆级集成中的先进封装。我们将首先研究推动这一技术发展的当前市场趋势。主要重点将放在扇出封装的各种平台和结构方面的分析上,并进一步深化 3D 封装,重点介绍互连技术,如中介层、硅通孔 (TSV) 和混合键合。此外,我们还将解决密集堆积的 3D 结构中散热、信号完整性、电力传输和翘曲问题的关键挑战。

## 演讲大纲:

- 市场趋势介绍
- 互连类型比较
- 小芯片堆叠的结构分析
- 挑战与解决方案

## 适合对象:

欢迎所有人,特别是对扇出和 3D 封装技术感兴趣的专业人士和学生。

## 演讲人简介:

王愉博获得美国纽约州立大学宾汉姆顿大学机械工程博士学位。

1997 年,在新加坡的 Gintic Institute of Manufacturing Technology 开始了职业生涯。

1998 年加入矽品,领导研发封装应用和技术支持团队,负责基板/封装设计、材料表征和先进封装。

王博士在封装表征方面拥有深厚的知识和经验,包括热/电仿真、先进材料(共同开发)、设计和先进封装开发。他在美国拥有超过 83 项专利。

## 经验:

- 1997-1998 新加坡 Gintic 制造技术研究所
- 1998 年至今 矽品 台湾